

0.02~6.0GHz 低噪声放大器

02505V1.1

特点:

频率范围: 0.02~6.0GHz功率增益: 典型值 20.0dB

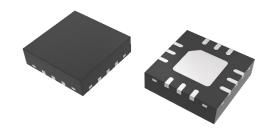
● 噪声系数: 典型值 1.5dB

● 输出-1dB 压缩点: 典型值+19.0dBm

● QFN 塑封

● 尺寸: 3.0×3.0×1.2mm

图片:



性能参数: (50Ω 系统, T_A=-55~+85℃)

参数名称	符号	测试条件	参数值			*	A7 334-
			MIN	TYP	MAX	单位	备注
频率范围	f	V_{D} =+5.00V f=0.02 \sim 6.0GHz P_{IN} =-20dBm	0.02		6.0	GHz	
功率增益	G		17.5	20.0	22.5	dB	
增益平坦度	ΔG			2.0	3.5	dB	
输入驻波	VSWRI			1.5:1	2.5:1		
输出驻波	VSWRo			1.5:1	3.0:1		
噪声系数	NF			1.5	2.5	dB	
		$V_D = +5.00V$, $f = 0.03 \sim 4.0 GHz$, $P_{IN} = -20 dBm$		1.2	2.0	dB	
反向隔离度	I_R	$V_D = +5.00V$, $f = 0.02 \sim 6.0 GHz$	20	25		dB	
输出-1dB 压缩点	OP-1dB	$V_D = +5.00V$, $f = 0.02 \sim 6.0 GHz$	+17.5	+19.0		dBm	
输出三阶截点	OIP ₃	双音信号间隔 1MHz,单音输出功率=+0dBm	+28	+31			
电源电压	V_{D}		+4.75	+5.00	+5.25	V	功能正常
工作电流	I_D	V _D =+5.00V, P _{IN} =-20dBm		70	100	mA	
质量	m				1	g	

功能框图:

ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS



引脚定义:

引脚编号	符号	描述		
2	RF _{IN}	射频输入端口, DC 耦合		
8	RF _{OUT}	射频输出端口, DC 耦合		
11	V_{D}	电源端口,+5.00V 供电		
1	RM	输入匹配		
3/7/9	GND	接地		
4/5/6/10/12	NC	内部悬空,建议接地		
底部中央焊盘	GND	接地		

极限参数表:

参数名称	极限值	
输入射频功率	+18dBm	
电源电压	0∼+5.5V	
装配温度	+260°C, 20s	
工作温度	-55∼+85℃	
贮存温度	-55∼+125℃	
潮湿敏感等级(MSL)	3	
静电放电敏感度等级	1A	

超过以上任何一项极限参数,可能造成器件永久损坏。

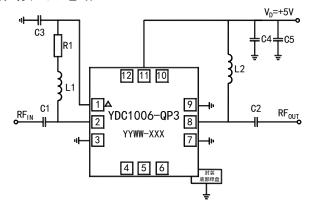


YDC1006-QP3

0.02~6.0GHz 低噪声放大器

02505V1.1

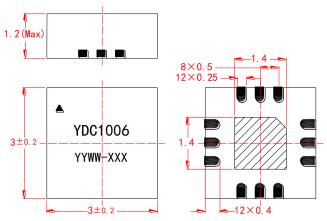
推荐应用电路:



推荐电路值:

rr-care:			
位号	型号/数值	备注	
C1、C2、C3	1nF		
C4	10nF		
C5	1nF		
L1、L2	2.2uH		
R1	20Ω		

外形尺寸图:



注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T 1804-m;

2、产品采用 QFN 塑封封装, 引脚表面镀镍钯金

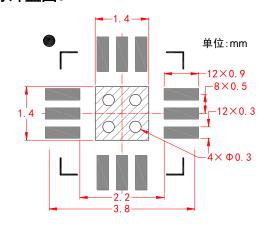
(Ni:0.5 \sim 2.0um, Pd:0.02 \sim 0.15um, Au:0.003 \sim 0.015um);

3、产品标识采用激光刻字。

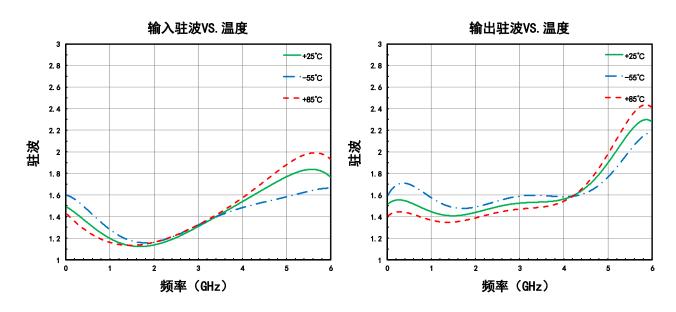
字符标志:

标识	说明	备注
YDC1006	产品型号	
•	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

推荐焊盘图:



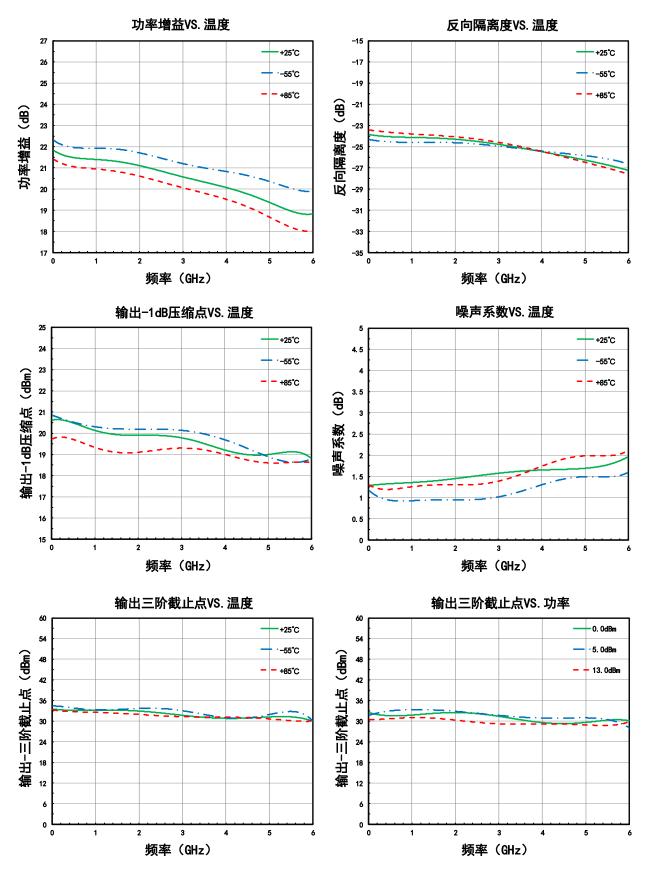
典型测试曲线: (50Ω 系统, V_D=+5.00V, P_{IN}=-20dBm)





YDC1006-QP3

0.02~6.0GHz 低噪声放大器 202505V1.1





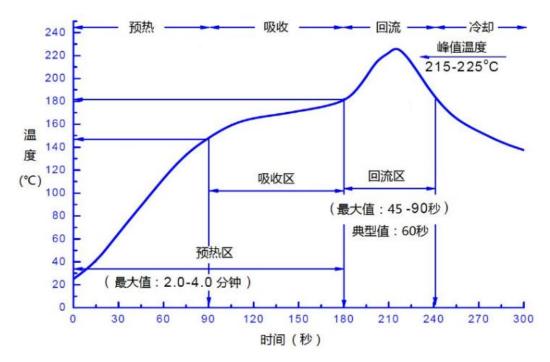
YDC1006-QP3

0.02~6.0GHz 低噪声放大器

202505V1 1

产品使用注意事项:

- 1. 产品属于静电敏感器件,产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
- 2. 产品属于3级潮湿敏感器件,产品在存储、操作、运输、包装使用过程须按IPC/JEDEC J-STD 相关要求执行。
- 3. 产品使用时请保证接地良好(GND引脚和底部金属化区域)。
- 4. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用,采用 Sn63/Pb37 锡膏,熔点+183℃回流焊接,回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线,因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线,实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

- 5. 如特殊情况产品需进行返工返修处理,在返工返修前应按 IPC/JEDEC J-STD MSL3 级要求对器件进行烘烤处理,避免返工返修过程加热对器件造成热损伤。回流及返工返修次数不大于 3 次。
- 6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境,客户在对产品焊接及清 洗完成后,应对产品进行三防喷涂处理,以提高产品耐环境适应性能力。